

加工事例：微細孔加工

Processed Sample of Micro Hole Processing

LPKF社が開発した革新的なガラス加工技術LIDE* Technologyを利用した微細加工は、ガラスに多数の真円度が高い孔を開けたり、ガラス端面の欠陥をなくしたりできるなど、破損のリスクを低減します。我々はこのLIDE技術を昨年より導入し、この加工を応用することでガラスの形状自由度を高めることも可能となりました。

Innovative micro hole processing with LIDE technology developed by LPKF Laser & Electronics AG allows large number of high roundness holes, free of micro cracks and chipping on the glass edge and reduce the risk of glass breakage. NEG have acquired this LIDE Technology last year, and by applying this technology, it is now possible to enable specific advantages and flexibility of glass shaping.

*LIDE : Laser Induced Deep Etching

